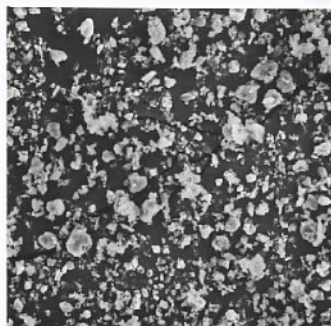


# シリコーンレジンパウダー

## ➤ MSP不定形シリーズ



日興リカの超微粒子不定形シリコーンパウダーは、シロキサン結合が三次元的に結合した構造(RSiO<sub>3</sub>/2)を持つポリメチルシルセスキオキサン微粒子です。

一般の有機系ポリマーと比較して耐熱性に優れており、また多くの有機溶剤に溶解しません。

**特長**

- ・従来の有機系微粒子に比べ耐熱性に優れている。
- ・撥水性、耐候性、耐摩耗性、潤滑性、絶縁性に優れている。

**用途**

- 半導体エポキシ封止剤:低応力化、耐湿性向上
- 自動車内装、電化製品向け塗料:意匠性付与、耐摩耗性向上
- PCM鋼板用塗料:潤滑性付与

### 一般特性

| 項目   | MSP-150(M)  | MSP-350M    | MSP-1500M   | MSP-3000M   | MSP-3000MX  |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 形状   | 不定形         | 不定形         | 不定形         | 不定形         | 不定形         |
| 含水率  | 1.0%以下      | 1.0%以下      | 1.0%以下      | 1.0%以下      | 1.0%以下      |
| 真比重  | 1.33        | 1.33        | 1.33        | 1.33        | 1.33        |
| 嵩比重  | 0.2~0.3g/ml | 0.2~0.3g/ml | 0.2~0.3g/ml | 0.2~0.3g/ml | 0.2~0.3g/ml |
| 粒度分布 | 1~106μm     | 1~45μm      | 1~25μm      | 1~25μm      | 1~10μm      |
| 平均粒径 | 20μm        | 13μm        | 9μm         | 6μm         | 3μm         |

(規格値ではありません)

製造元



日興リカ株式会社